

Transfer Molding System

Model YPM1250-EPQ



Transfer molding system for 2.5D/3DIC/Chiplet products

2.5D/3DIC/チップレット製品向け トランスファモールド装置

製品情報



日本語

- 個片基板サイズ□150mm(6インチ)まで対応可能な大型プレス
- 個片基板搬送用ポートキャリアにも対応
- エッジゲートデザインによりサイドレールフラッシュなど樹脂漏れを抑制
- 大容量フローキャビティ 及び R.F.C.P.®によりチップサイズが大きく
充填難易度の高い大型チップのMUF成形を達成
- ダブルプランジャーにより、大面積パッケージの樹脂量にも対応
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	YPM1250-EPQ			
ワークタイプ		—	基板			
ワークサイズ		mm	□60—□150/100×300 (Max.)			
ポートキャリアサイズ	長さ	mm	310—390			
	幅	mm	160—200			
樹脂	径	mm	φ14, 16, 18, 20			
	長さ	mm	14.3—35.0			
マシンタイム		sec	Approximately 108			
外形寸法	プレス数	module	1	2	3	4
	幅	mm	5,240	6,240	7,240	8,240
	奥行き	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
	高さ	mm	2,685	2,685	2,685	2,685
重量		ton	15.0	23.0	31.0	40.0
成形取り数	ワークサイズ □60—□90	workpiece	6			
	ワークサイズ □85—□150	workpiece	4			
インプットマガジンスペース		mm	870			
アウトプットマガジンスペース (スリットマガジン仕様)		mm	870			
クランプ出力		kN/(tf)	294.0—2,450.0/30.0—250.0			
トランスファ出力		kN/(tf)	9.8—98.0/1.0—10.0 (2圧設定)			
品種切替え方式		—	キット交換式			
搭載可能金型		—	YPM1250-EPQ専用金型			
リリースフィルム幅		mm	100—530			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。
R.F.C.P.はTOWA株式会社の日本における登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ